

高周波基板材料向けCCL エクシラム® Fシリーズ

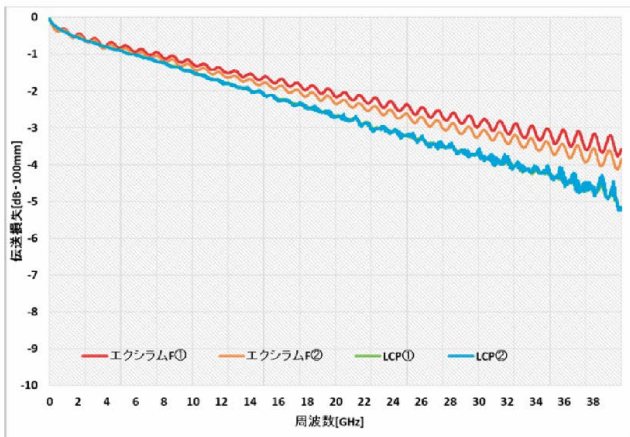
特長

- ・AGC株式会社製フッ素樹脂「Fluon+™ EA-2000」をベースにした無接着剤タイプの銅張積層板です。
- ・これまでのポリイミド及びLCPベースのFCCLに比べ、非常に低い伝送損失を実現しています。

一般特性

グレード			FBE1340VSP	FBR1340BC2	備考	
厚み構成 Cu/絶縁層/Cu(μm)			12/100/12		—	
銅箔種			高周波用電解箔	高周波用圧延箔	—	
ピール強度	常態		N/mm	1.1	1.3	UEXC法
寸法変化率	銅箔エッチング後	MD	(%)	-0.08	-0.02	UEXC法
		TD		-0.08	-0.05	
	熱処理後 150°C×30分	MD		-0.10	-0.03	
		TD		-0.09	-0.06	
半田耐熱性	288°C×1分		—	Pass	Pass	UEXC法

伝送損失特性比較



ビア加工性

CO2レーザー加工例

- ・デスマリア: ドライデスマリア2回処理
+ ウェットデスマリア処理
- ・メッキ処理: ダイレクトプレーティング電解メッキ

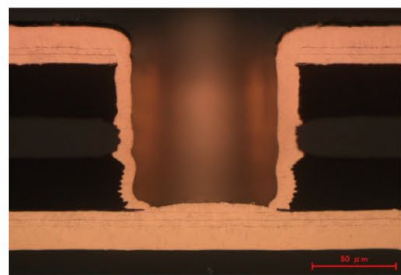


写真: エキシラムFメッキ後製品断面

構成



測定条件

- ・マイクロストリップライン (カバーレイなし)
- ・回路長: 100 mm
- ・インピーダンス: 50 Ω
- ・温度: 23°C, 湿度: 50%RH
- ・①前処理: 23°C, 50%RH, 24hr
- ・②前処理: 85°C, 85%RH, 72hr

- ・一般特性および伝送損失特性については代表値であり、保証値ではありません。
- ・記載されているデータは見直されることがあります。

「エクシラム」は宇部エクスモ(株)の日本における登録商標です。

「Fluon+™」はAGC株式会社の商標です。